

10A、600V N沟道增强型场效应管

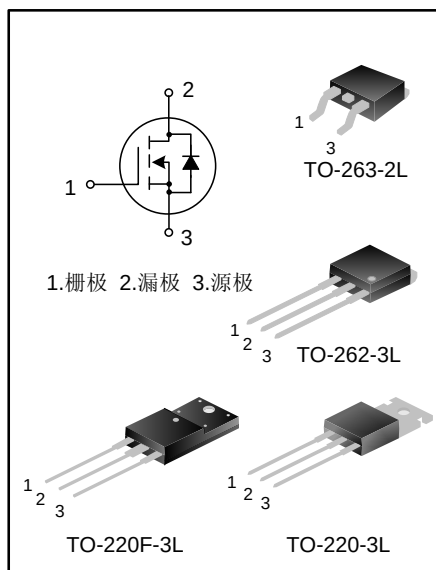
描述

SVF10N60T/F/S/K N 沟道增强型高压功率 MOS 场效应晶体管采用士兰微电子的 F-Cell™ 平面高压 VDMOS 工艺技术制造。先进的工艺及条状的原胞设计结构使得该产品具有较低的导通电阻、优越的开关性能及很高的雪崩击穿耐量。

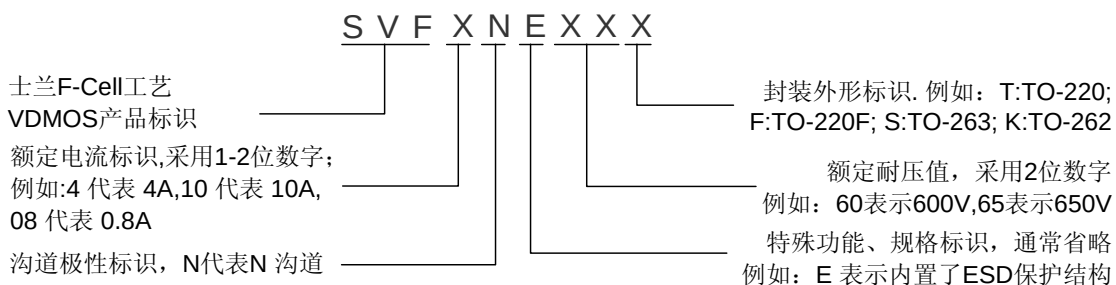
该产品可广泛应用于 AC-DC 开关电源, DC-DC 电源转换器, 高压 H 桥 PWM 马达驱动。

特点

- * 10A, 600V, $R_{DS(on)}$ (典型值)= 0.75Ω @ $V_{GS}=10V$
- * 低栅极电荷量
- * 低反向传输电容
- * 开关速度快
- * 提升了 dv/dt 能力



命名规则



产品规格分类

产 品 名 称	封装形式	打印名称	材料	包装
SVF10N60T	TO-220-3L	SVF10N60T	无铅	料管
SVF10N60F	TO-220F-3L	SVF10N60F	无卤	料管
SVF10N60S	TO-263-2L	SVF10N60S	无铅	料管
SVF10N60STR	TO-263-2L	SVF10N60S	无铅	编带
SVF10N60K	TO-262-3L	SVF10N60K	无卤	料管

极限参数(除非特殊说明, $T_C=25^{\circ}\text{C}$)

参数名称		符号	参数范围				单位
			SVF10N60T	SVF10N60F	SVF10N60S	SVF10N60K	
漏源电压		V _{DS}	600				V
栅源电压		V _{GS}	±30				V
漏极电流	T _C =25℃	I _D	10				A
	T _C =100℃		7				
漏极脉冲电流		I _{DM}	40				A
耗散功率（T _C =25℃） - 大于 25℃ 每摄氏度减少		P _D	156	50	150	148	W
			1.25	0.4	1.20	1.18	W/℃
单脉冲雪崩能量（注 1）		E _{AS}	654				mJ
工作结温范围		T _J	-55～+150				℃
贮存温度范围		T _{sta}	-55～+150				℃

热阻特性

参 数 名 称	符 号	参数范围				单 位
		SVF10N60T	SVF10N60F	SVF10N60S	SVF10N60K	
芯片对管壳热阻	$R_{\theta JC}$	0.8	2.5	0.83	0.84	$^{\circ}\text{C/W}$
芯片对环境的热阻	$R_{\theta JA}$	62.5	62.5	62.5	62.5	$^{\circ}\text{C/W}$

电性参数(除非特殊说明, $T_C=25^{\circ}\text{C}$)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
漏源击穿电压	$B_{V_{DS}}$	$V_{GS}=0V, I_D=250\mu A$	600	--	--	V
漏源漏电流	I_{DSS}	$V_{DS}=600V, V_{GS}=0V$	--	--	1.0	μA
栅源漏电流	I_{GSS}	$V_{GS}=\pm 30V, V_{DS}=0V$	--	--	± 100	nA
栅极开启电压	$V_{GS(th)}$	$V_{GS}=V_{DS}, I_D=250\mu A$	2.0	--	4.0	V
导通电阻	$R_{DS(on)}$	$V_{GS}=10V, I_D=5.0A$	--	0.75	1.0	Ω
输入电容	C_{iss}	$V_{DS}=25V, V_{GS}=0V,$ $f=1.0MHz$	--	1132	--	pF
输出电容	C_{oss}		--	135	--	
反向传输电容	C_{rss}		--	3.91	--	
开启延迟时间	$t_{d(on)}$	$V_{DD}=300V, I_D=10A,$ $R_G=25\Omega$ (注 2, 3)	--	32.33	--	ns
开启上升时间	t_r		--	60.40	--	
关断延迟时间	$t_{d(off)}$		--	58.67	--	
关断下降时间	t_f		--	38.67	--	
栅极电荷量	Q_g	$V_{DS}=480V, I_D=10A,$ $V_{GS}=10V$ (注 2, 3)	--	19.38	--	nC
栅极-源极电荷量	Q_{gs}		--	6.26	--	
栅极-漏极电荷量	Q_{gd}		--	6.55	--	

源-漏二极管特性参数

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
源极电流	I_S	MOS 管中源极、漏极构成的反偏 P-N 结	--	--	10	A
源极脉冲电流	I_{SM}		--	--	40	
源-漏二极管压降	V_{SD}	$I_S=10A, V_{GS}=0V$	--	--	1.3	V
反向恢复时间	T_{rr}	$I_S=10A, V_{GS}=0V, dI_F/dt=100A/\mu S$ (注 2)	--	535.39	--	ns
反向恢复电荷	Q_{rr}		--	4.6	--	μC

注:

1. $L=30mH, I_{AS}=6.0A, V_{DD}=150V, R_G=25\Omega$, 开始温度 $T_J=25^\circ C$;
2. 脉冲测试: 脉冲宽度 $\leq 300\mu s$, 占空比 $\leq 2\%$;
3. 基本上不受工作温度的影响。

典型特性曲线

图1. 输出特性

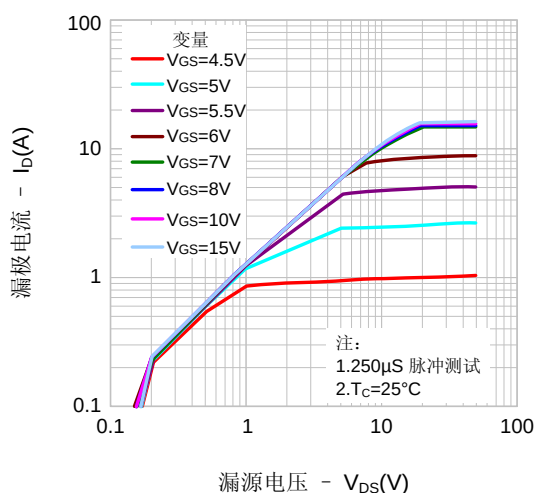


图2. 传输特性

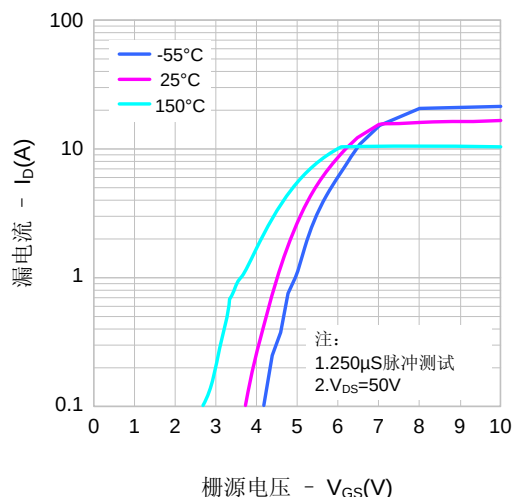


图3. 导通电阻 vs. 漏极电流

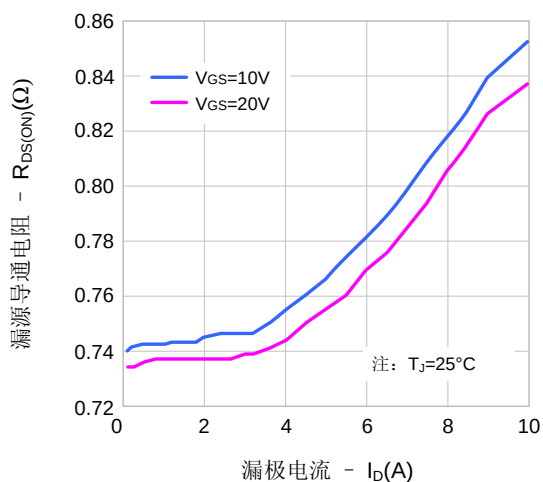
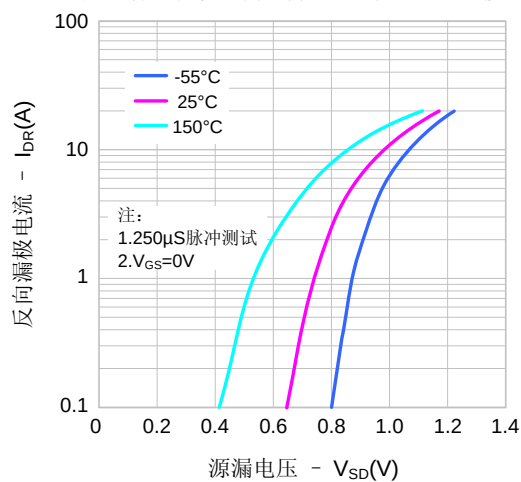


图4. 体二极管正向压降 vs. 源极电流、温度



典型特性曲线（续）

图5. 电容特性

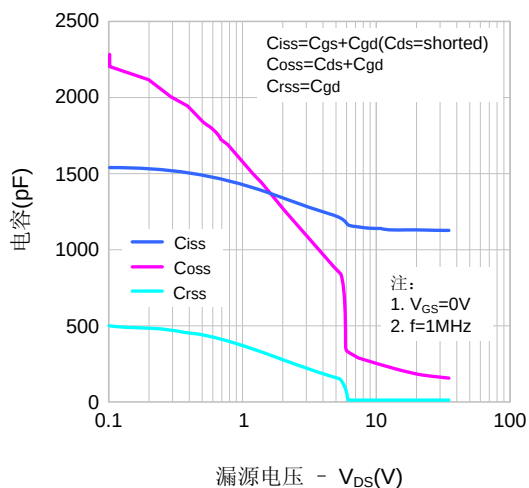


图6. 电荷量特性

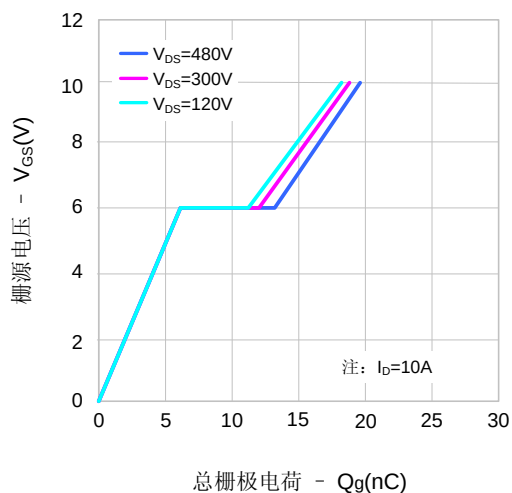


图7. 击穿电压vs.温度特性

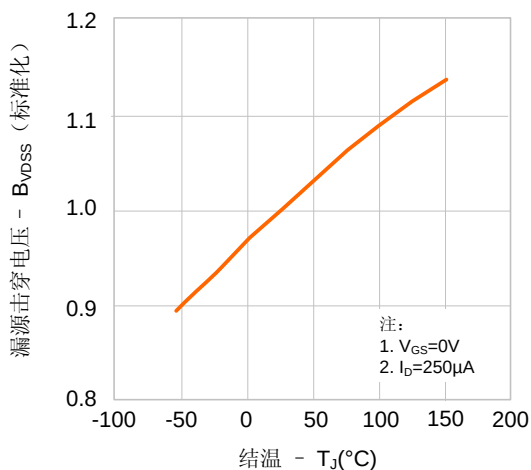


图8. 导通电阻vs.温度特性

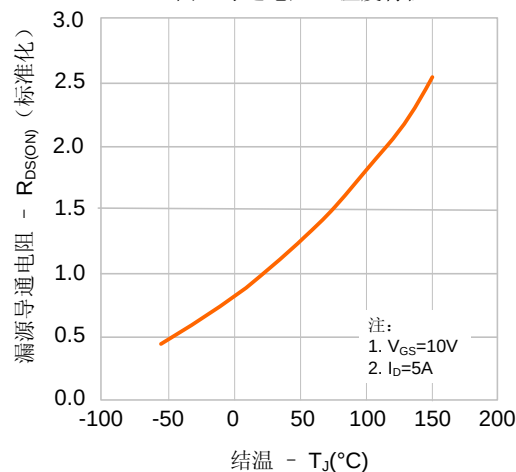


图9-1. 最大安全工作区域(SVF10N60T)

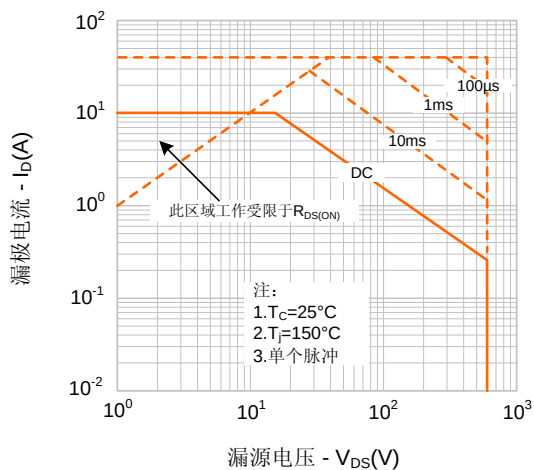
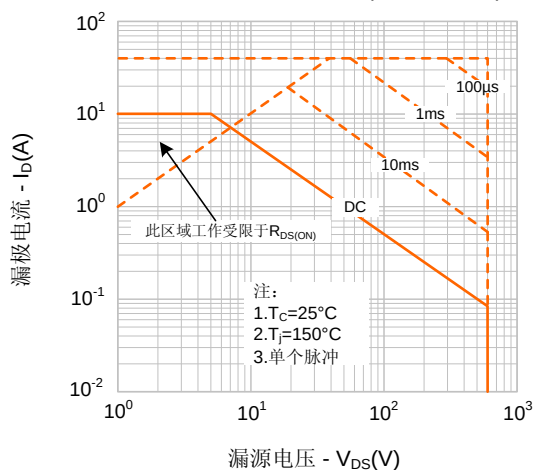


图9-2. 最大安全工作区域(SVF10N60F)



典型特性曲线（续）

图9-3. 最大安全工作区域(SVF10N60S)

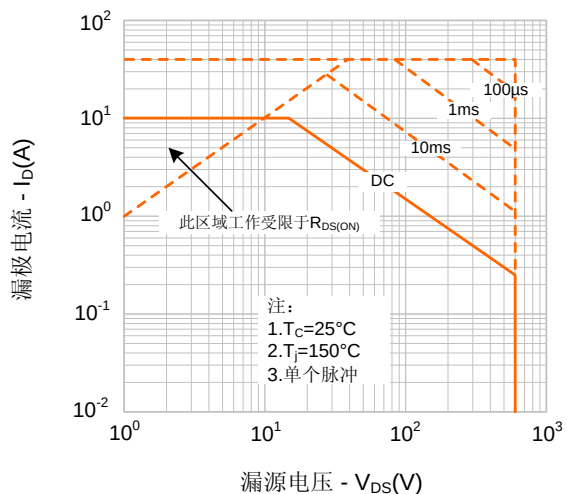


图9-4. 最大安全工作区域(SVF10N60K)

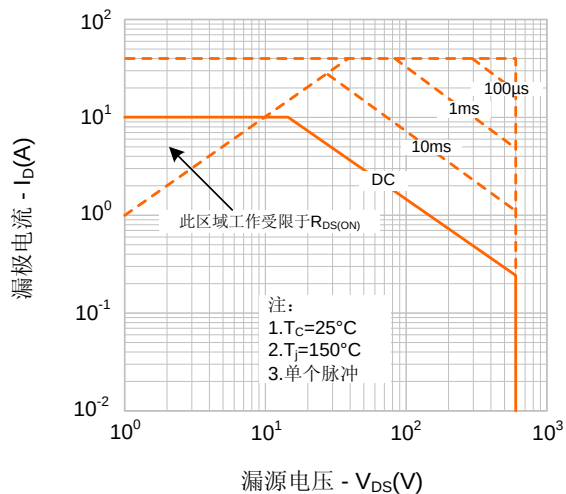
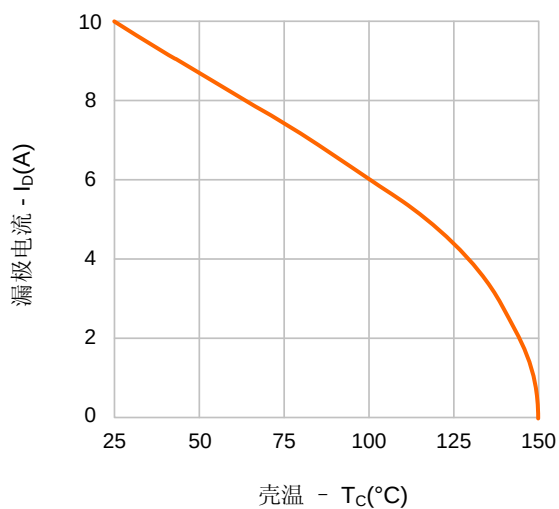
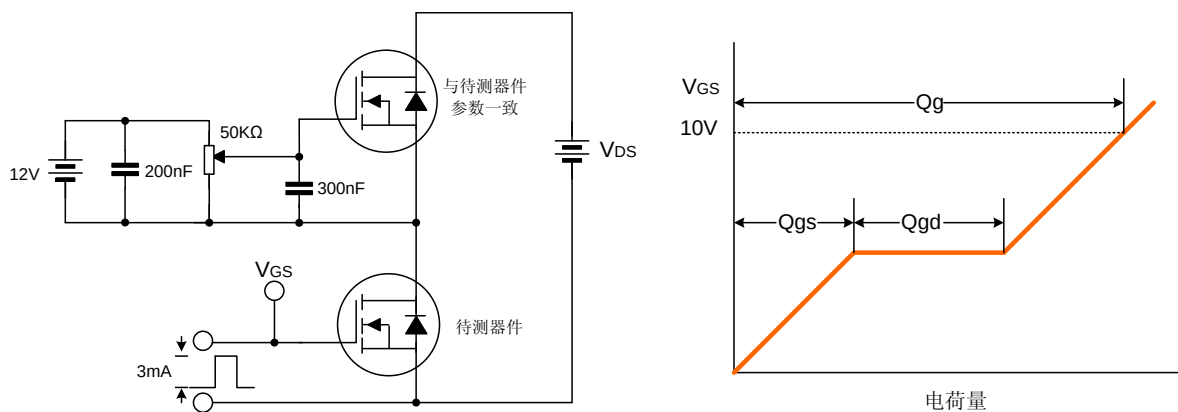


图10. 最大漏电流vs. 壳温

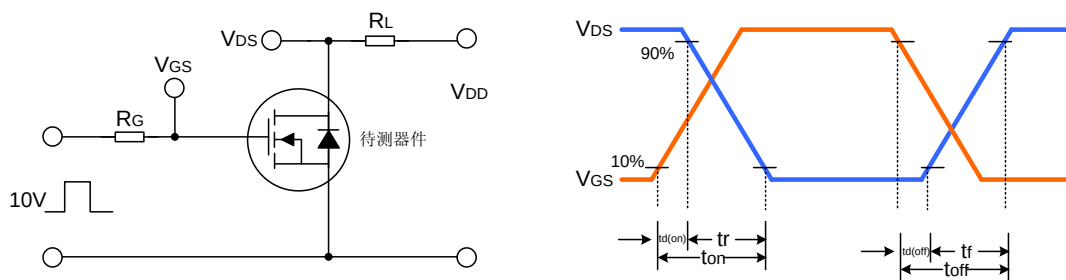


典型测试电路

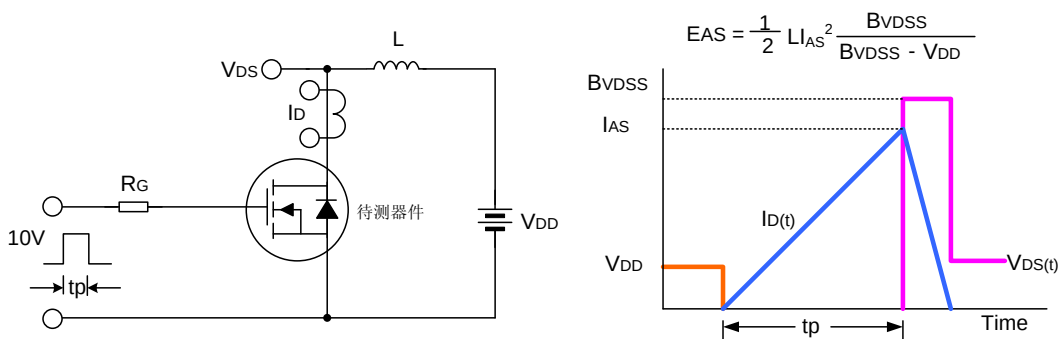
栅极电荷量测试电路及波形图



开关时间测试电路及波形图



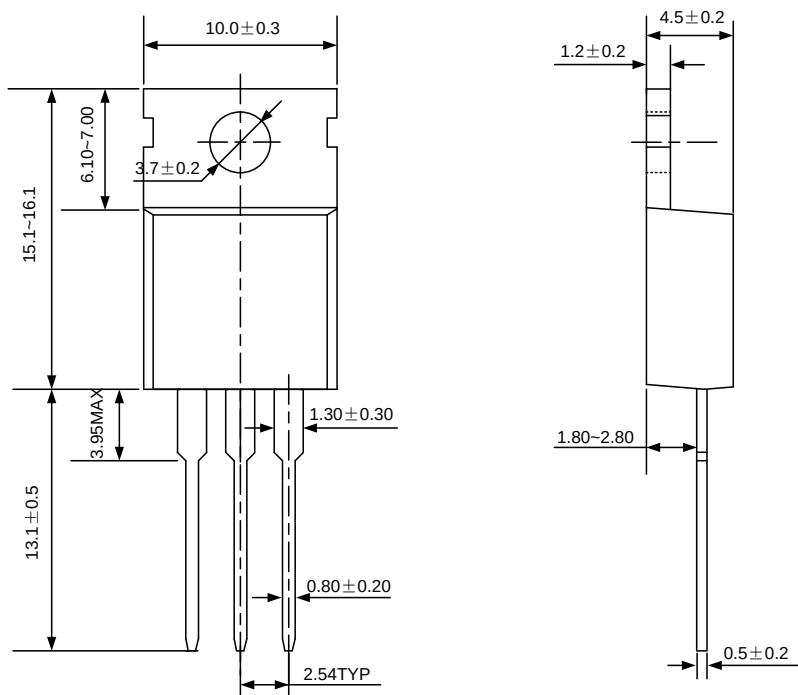
EAS测试电路及波形图



封装外形图

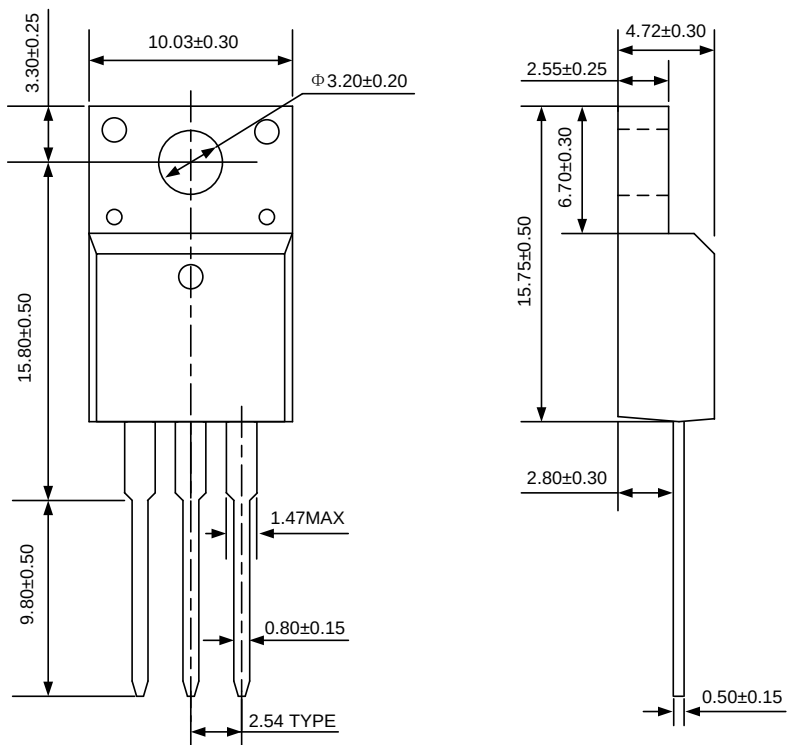
TO-220-3L

单位: mm

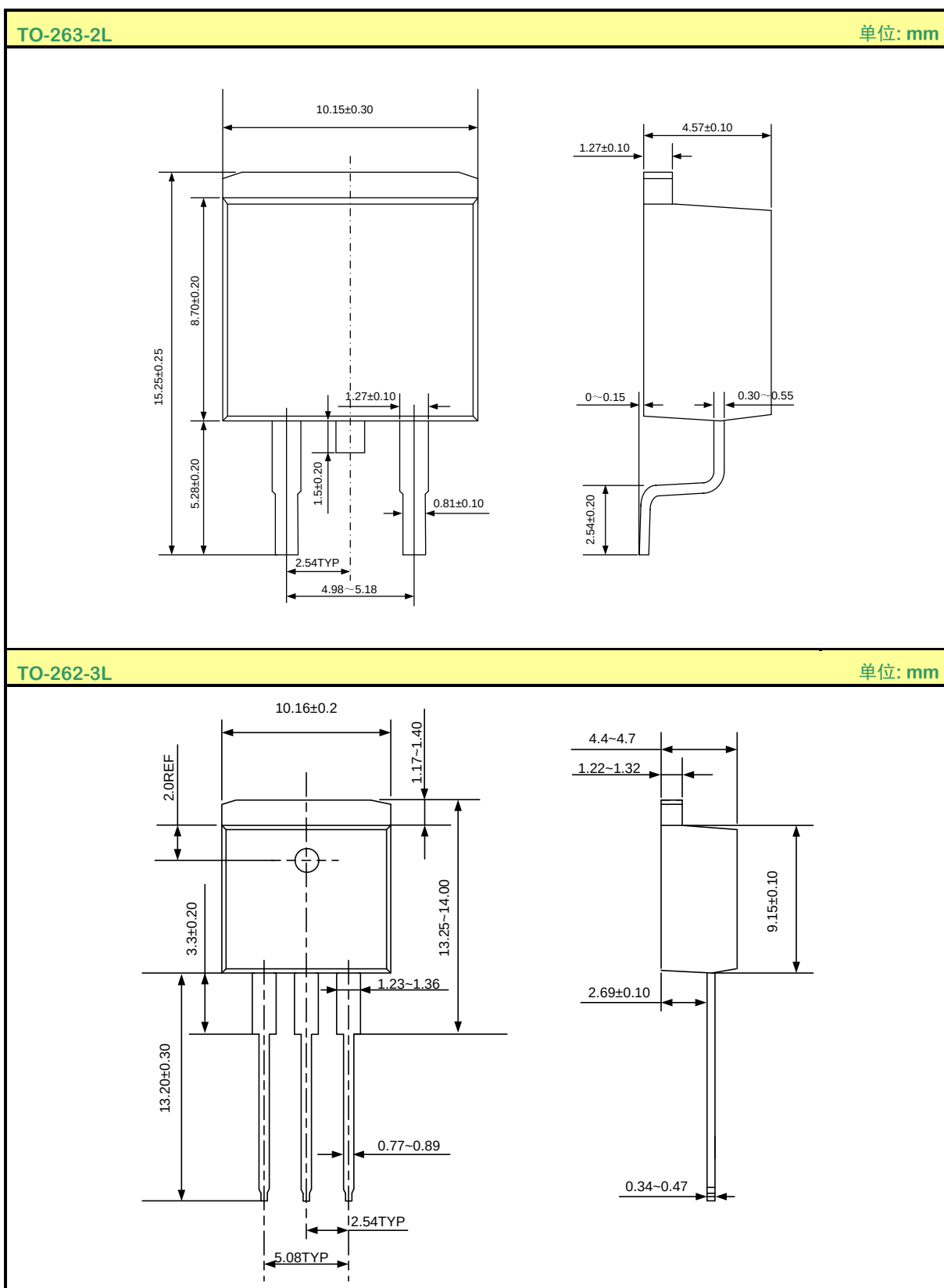


TO-220F-3L

单位: mm



封装外形图（续）





声明:

- 士兰保留说明书的更改权,恕不另行通知!客户在下单前应获取最新版本资料,并验证相关信息是否完整和最新。
- 任何半导体产品特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能,买方有责任在使用 Silan 产品进行系统设计和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施,以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生!
- 产品提升永无止境,我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品!

附:

修改记录:

日期	版本号	描 述	页 码
2011.01.24	1.0	原版	
2011.05.17	1.1	增加TO-263-2L封装	
2011.09.02	1.2	修改“封装外形图”	
2012.01.18	1.3	增加TO-262-3L封装	
2012.04.11	1.4	增加SVF10N60F的无卤信息	
2012.06.04	1.5	修改 T_{rr} 和 Q_{rr} 的值	
2013.08.21	1.6	修改“封装外形图”	
2013.11.13	1.7	修改MOS管符号的示意图	
2014.04.23	1.8	修改产品规格分类	
2015.02.13	1.9	修改热阻特性	